

**Zur Verstärkung suchen wir ab sofort
für unseren Standort Berlin eine/n engagierte/n**



PROJEKTLEITER (W/M/D)

Ihre Aufgaben:

- Konzeption, Planung und Durchführung von technischen Projekten mit dem Schwerpunkt Aufbau- und Verbindungstechnik (speziell COB, FlipChip)
- Erstellen von Machbarkeitsstudien für neue Packaging Konzepte basierend auf Kundenanforderungen
- Eigenverantwortliches Erarbeiten von Informationen für die Angebotserstellung
- Leiten von Kundenprojekten von der Auftragserteilung bis zur Überführung in die Serienfertigung
- Überwachung und Reporting bzgl. Kosten, Termine und Leistungen im Projekt
- Koordination von internen und externen Partnern im Projekt
- Kommunikation mit Kunden, Lieferanten und internen Abteilungen - insbesondere mit der Gruppe Process Engineering
- Gelegentliche Reisetätigkeit

Unsere Anforderungen:

- Abgeschlossenes Ingenieursstudium im Bereich Elektronik, Mikrosystemtechnik oder vergleichbar
- Mehrjährige Berufserfahrung als Projektleiter
- Sehr gute Fachkenntnisse im Bereich Aufbau- und Verbindungstechnik, speziell COB und FC
- Kreativität und analytisches Denkvermögen
- Kosten- und Qualitätsbewusstsein
- Selbständige, zielorientierte Arbeitsweise
- Sehr gute Englischkenntnisse, jede weitere Fremdsprache ist von Vorteil
- Persönlich zeichnen Sie sich durch ein gesundes Durchsetzungsvermögen aus und verfügen über ein selbstsicheres Auftreten mit ausgewiesener Kommunikationsstärke

Sie finden sich bei uns in einem engagierten und kollegialen Team wieder.

Wir bieten Ihnen moderne Infrastruktur, eine Tätigkeit in einer Branche mit Prestige und Entscheidungskompetenz sowie mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und Entfaltungsmöglichkeiten.

Interessiert?

Nutzen Sie die Chance auf die Mitarbeit in unserem motivierten Team und senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung, bevorzugt per Mail im PDF-Format, an: hr@aemtec.com

AEMtec GmbH

Die AEMtec GmbH, mit Firmensitz und Fertigungsstätte am renommierten Wissenschafts- und Technologiestandort Berlin Adlershof, bietet modernste Technologien für kundenspezifische komplexe (opto-) elektronische Anwendungen. Das Unternehmen verfügt über ein breites Spektrum an Aufbau- und Verbindungstechnologien, wie UBM, Solder Ball Attach, Stud Bumping, Chip on Board, Flip Chip, 3D-Integration und Opto-Packaging. Umfangreiche Entwicklungsdienstleistungen im Bereich Machbarkeitsstudien zur Aufbau- und Verbindungstechnik, Design und Layout sowie Testequipment-Erstellung bis hin zur Serienproduktion runden das Dienstleistungsspektrum ab.

Wir bieten:

- eine angenehme, motivierende Arbeitsatmosphäre
- eine gründliche Einführung
- flexible Arbeitszeiten
- individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
- eine leistungsgerechte Vergütung, inkl. Erfolgsprämien
- ein modernes Arbeitsumfeld am renommierten Wissenschafts- und Technologiestandort Berlin-Adlershof
- eine attraktive Work-Life-Balance